

### 検査概要

フィルム基板等における微細な傷は、致命的な問題です。5 $\mu$ 以上の微細な傷を高速に検出する装置は、インラインで使用できるようフィルムサイズ及び検査タクトに合わせて構成できます。

### 機能概要/特徴

- ・フィルム表面に発生する5 $\mu$ 以上の傷を高速に検出します。
- ・フィルム基板の場合は、線パターンの太い/細いの検出も可能です。
- ・フィルムサイズに合わせ構成変更可能です。
- ・検査方式は、ラインセンサーカメラからの撮像データを高速画像処理で検出します。
- ・検査画像を保存する事により、トレーサビリティの役割にも最適です。

### 検査の内容

#### ■装置/システム

項目	高解像度版	中解像度版	低解像度版
分解能 (高さ精度)	0.2 $\mu$ m	1 $\mu$ m	5 $\mu$ m
分解能 (幅精度)	2.5 $\mu$ m	20 $\mu$ m	60 $\mu$ m
取込み速度	0.3125mm/秒	3.125mm/秒	18.75mm/秒
レーザー光 青色	波長域：400から430nm		
源 赤色	波長域：635から690nm		
測定対象物と検出内容	金属/樹脂 (傷、クラック、打痕) ※その他素材については、ご相談願います		
コントローラ	OS : Windows 7 (32/64bits)、CPU : Corei5 メモリー 8 GB、Nvidea GPU		
基本機構	検査台 (カメラ設置 + 搬送器) ※検査機のお客様既存ラインへのインライン組込みについては別途御相談可能です		

#### ■処理の流れ

搬送⇒撮像⇒傷検出を高速処理⇒判定結果⇒良品・不良品信号出力

#### ■検査画像/処理結果

